

カンパニープレジデントメッセージ

私達は、我がカンパニー発足以来、「すべてのお客様の製造プロセスに係わる‘水(Wet)と空気(Vacuum)と環境(Clean)’の分野で、‘優れた技術と最良のサービスを提供’」することをコミットし、努力を続けています。

E-Plan2016の基本方針はすべてのお客様からのニーズから生まれたものです。お客様の「最新技術に対応できる革新技術」「最短納期に俊敏に対応できる生産技術」「世界中で同一内容のサービス提供」などのご要望に応えるために、①常に革新的な次世代モデルを投入し、②絶え間ない生産革新を推進し、③世界中、お客様のいるところに適正人材を配置し、これらを「誠心、信頼心そして雄心」の心で対応しています。

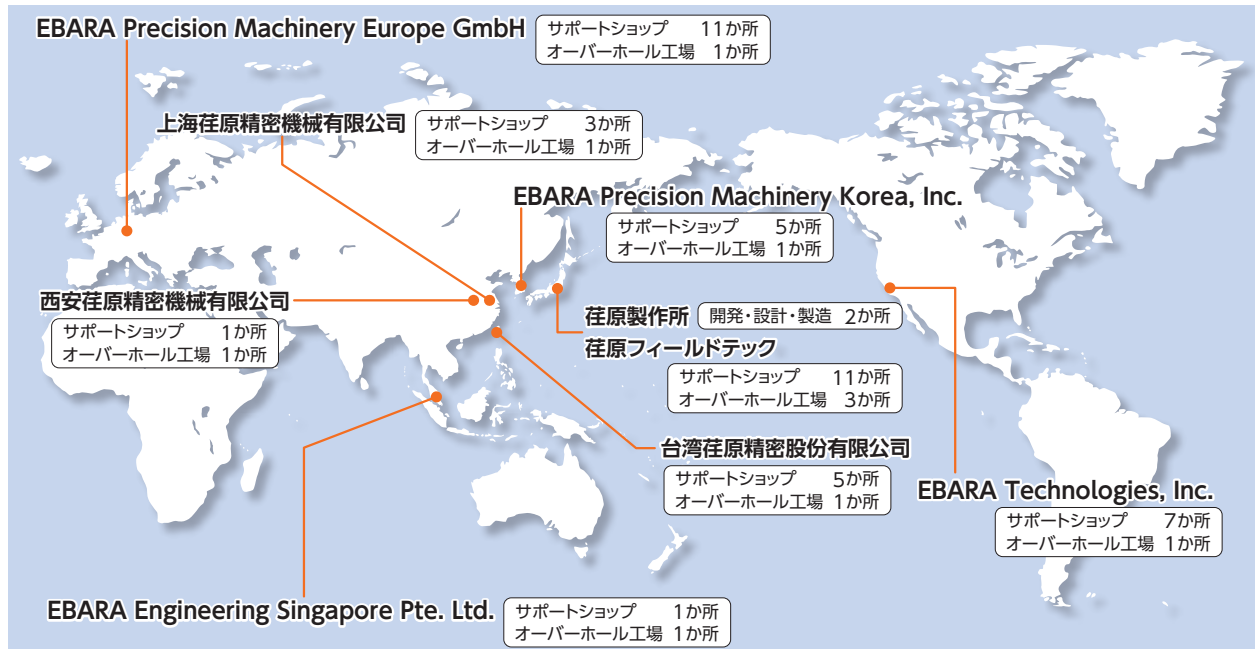
益々発展する半導体・フラットパネル・太陽電池・LEDなどの最先端技術に適合する製品と環境技術を提供し、お客様に満足いただくとともに社会にそして地球に貢献して行きたいと思えます。今後ともご支援・ご指導よろしくお願ひ申し上げます。



執行役専務
精密・電子事業カンパニー
プレジデント 辻村 学

お客様のニーズに迅速に応える体制

精密・電子事業カンパニーの主な拠点



2020年3月期にありたい姿

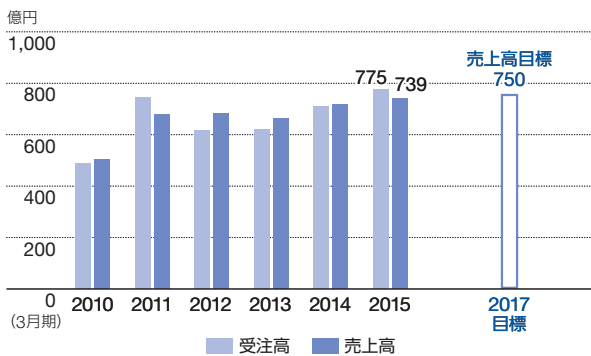
半導体市況の波に関わらず中期的に平均売上高営業利益率10%以上を確保した上で、真空排気系製品、CMP装置に続く第3の柱となる製品群を育成し、持続可能な成長に向けた事業基盤を構築することを目指しま

す。また、当事業のコア技術である「精密回転機械技術」と「プロセス加工技術」そして、「顧客に密着した開発」をより充実させ、既存技術の応用によるアプリケーションの拡大を行い、中長期的な観点で市場投入を目指します。

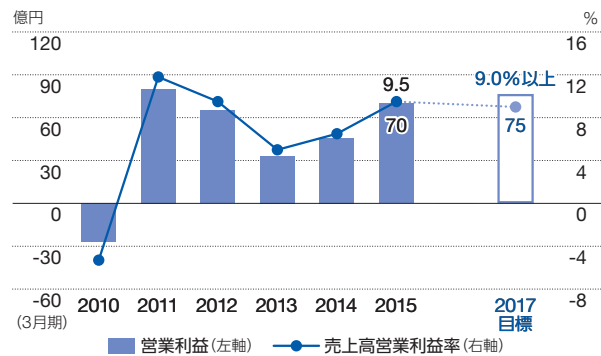
E-Plan2016における事業戦略

機会	リスク
<ul style="list-style-type: none"> ● モバイル端末の市場拡大に伴う半導体需要の拡大 ● LED、フラットパネル、太陽電池などの市場の拡大 	<ul style="list-style-type: none"> ● 半導体製造メーカーの設備投資計画の縮小

受注高／売上高



営業利益／売上高営業利益率



E-Plan2016業績目標

売上高(2017年3月期)	750 億円
営業利益(2017年3月期)	75 億円
売上高営業利益率(2017年3月期)	9.0 %以上

詳細は、統合報告書をご覧ください。

E-Plan2016基本方針

- ① 半導体設備投資サイクルに左右されない安定した事業体質を構築します。また、市場の低迷が続く半導体分野(LED、液晶パネル、ソーラーパネル、リチウムイオン電池など製造装置分野)は市場回復時に備えた対応をします。
- ② 市場の変動に対して俊敏に対応できる弾力性を持った事業運営により、期間平均売上高営業利益率水準の改善を図ります。
- ③ 注力市場(台湾・韓国・米国及び日本)での競争に打ち勝つために必要なマーケティング、開発、技術、生産、品質保証、営業、サービス&サポートといった全ての分野における人材を採用・育成し、国内外拠点における人材配置を最適化します。

2014年度の主な成果と今後の計画

■ 市場の変化に対して俊敏に対応できる弾力性を持った事業経営

中期計画において、主要顧客である半導体顧客の変動する需要に対して俊敏に対応すること、今後の市場拡大に備えフラットパネル、LED、PVなどの非半導体市場でのポジションの確保をすること、また、アフターサービス事業の安定拡大を図ること、を中心に事業運営行っています。

2014年度は、顧客との関係の向上に努めつつ、コンポーネント製品を中心に、受注売上拡大に努めました。CMP装置においては、主要半導体顧客に対して、F-REX300X型など顧客ニーズに対応する新製品の投入を行い顧客の微細化投資に対応しました。また、非半導体市場では、グローバル販売ネットワークを通して拡販に注力しシェア拡大に努めました。

アフターサービス事業では、中国西安市に顧客サポートを目的とした西安荏原精密機械有限公司設立を行うなどグローバルサポート体制の充実を図りました。

今後も、2014年度の顧客密着型事業活動を継続し、市場の変化に対して俊敏に対応しつつ、シェア拡大、収益力向上を目指していきます。

■ 安定した事業体質の構築

2014年度は、変化の激しい市場に迅速に対応できる生産体制構築に注力しました。顧客密着型営業活動を通して、顧客の生産や投資スケジュールの把握に努め、主

力製品のドライ真空ポンプ、CMP装置を中心に、現在推進中の生産革新活動により、生産の平準化、及びリードタイムの短縮を図り、原価低減及び生産性向上に努めました。

また、台湾でのドライ真空ポンプ生産を安定化させ、半導体顧客ニーズにより迅速に対応するために、グローバル生産体制の充実を図りました。

今後は、製造工程の改善に加え、設計・生産効率を徹底的に追求した「ものづくり」へと更に深化させていきます。

また、これまでの生産革新活動で得られた知見をめぐき装置・ベベル研磨装置・排ガス処理装置などの他製品へ迅速に展開していきます。

■ 競争に打ち勝つための人材採用と育成

当カンパニーは、米国、台湾、韓国、日本を中心に、事業展開・拡大を着実に図っていくためには、それぞれ地域の文化、習慣、また、ビジネススタイルを理解し柔軟に対応できる人材を確保することが必要不可欠であると考えます。

この目的を達成するために、連結従業員のうち、営業、製品サポートフィールドエンジニア、ドライ真空ポンプ生産・修理工場を中心に半数以上は海外子会社の外国籍従業員となっています。また、外国駐在員も多数派遣しており、顧客対応など外国籍従業員とともに、チームで対応しています。また、当カンパニー本部にも積極的に

職種を問わず外国籍者を従業員として採用しています。
2014年度は、この従業員育成方針のもと、米国、台湾を中心に人材配置の適正化を図りました。

今後も、この育成方針を継続し、グローバルな顧客ニーズに迅速に対応できる体制の充実を図っていきます。

2014年度トピックス

■ TSMC社から3年連続Excellent Performance In CMP Equipment

荏原は、Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.,Ltd.(本社：台湾、以下TSMC社)から“Excellent Performance in CMP Equipment”を授与されました。3年連続、5回目の受賞となります。2014年12月4日に行われた第14回Annual Supply Chain Management Forumで、600社超のサプライヤーが参加する中、授賞式が行われ、9社が受賞しました。荏原の受賞理由として、「TSMC社の新たな技術領域へのサポート」「台湾に先進的なトレーニングセンターを開設したこと」の2点があげられました。

Excellent Performance Awardは、毎年、TSMC社が傑出した性能を発揮したり、サービス・サポートを提供したりしたサプライヤーを数社選定し、表彰するものです。

荏原のコアビジネスの一つである半導体製造装置及びコンポーネント製品を供給する精密・電子事業カンパニーは、今後も、お客様の生産性向上やトータルコストの削減に貢献する製品・サービスを提供していきます。

TSMC社からの受賞の歩み

- 2008年～2013年:Supplier Excellence Award(CMP equipment)賞を受賞
- 2014年:Excellent Performance in CMP Equipment賞を受賞

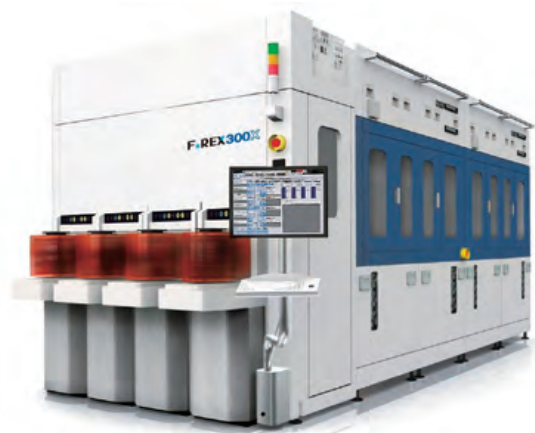


受賞の盾をTSMC社President & Co-CEO, Dr. Mark Liu氏(右)より受け取る荏原製作所 精密・電子事業カンパニープレジデント 辻村 学(左)

■ 新型CMP装置 F-REX300X型を発表

主力製品であるCMP装置の新機種F-REX300X型を2014年12月に発表しました。新機種では、洗浄ユニットを増やしたことによって機器を稼働させた状態での消耗材交換等のメンテナンス性が一層改善され、真のノンストップCMP装置が実現しました。更に、機械搬送能力がF-REX300SII型(現行主力機種)の約2倍となり、短時間プロセスでの生産性を大幅に向上させました。CMP装置は、半導体チップの製造過程においてナノメートル(1ナノは百万分の1ミリ)の単位で求められる平坦性を化学的機械的に研磨する装置です。

F-REX300SII型でも採用している当社独自の“1テーブル・1ヘッド”“4テーブル・プラットフォーム”のコンセプトは、高スループットを可能とし、年々高まるプロセス要求性能の達成と高い生産性の両方を実現しています。そのため、半導体デバイス微細化の最先端で使用される銅配線の平坦化プロセスを中心に、多くのお客様に採用いただいています。今回、F-REX300X型をCMP装置のラインナップに加え、より幅広いお客様のニーズに応えることが可能となりました。



新型CMP装置 F-REX300X型を発表